



台積公司和格芯宣布透過全球專利交互授權全面解決雙方爭訟

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司、格芯

發佈日期：2019年10月29日

台灣積體電路製造股份有限公司與格芯（GlobalFoundries）今（29）日宣布撤銷雙方之間及與其客戶相關的所有法律訴訟。隨著台積公司和格芯持續大幅投資半導體研究與開發，兩家公司已就其現有及未來十年將申請之半導體技術專利達成全球專利交互授權協議。

此項協議將確保台積公司及格芯的營運不受限制，雙方客戶並可持續獲得兩家公司各自完整的技術及服務。

格芯執行長Thomas Caulfield表示：「我們很高興能夠很快地和台積電達成協議，此項協議認可了雙方智慧財產的實力，使我們兩家公司能夠聚焦於創新，並為雙方各自的全球客戶提供更好的服務。同時，該協議也確保了格芯持續成長的能力，對於身為全球經濟核心的半導體業而言，也有利整個產業的成功發展。」

台積公司副總經理暨法務長方淑華表示：「半導體產業的競爭一直以來都相當激烈，驅使業者追求技術創新，以豐富全球數百萬人的生活。台積公司已投入數百億美元資金進行技術創新，以達今日的領導地位。此項協議是相當樂見的正面發展，使我們持續致力於滿足客戶的技術需求，維持創新活力，並使整個半導體產業更加蓬勃昌盛。」



關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，並一直是全球最大的專業積體電路製造服務公司。台積公司以業界先進的製程技術及設計解決方案組合支援一個蓬勃發展的客戶及夥伴的生態系統，以此釋放全球半導體產業的創新。

2019 年，台積公司全球總產能超過 1,200 萬片之十二吋晶圓約當量，台積公司並提供最廣泛的製程技術，全面涵蓋自 2 微米製程至最先進的製程技術，即現今的 7 奈米製程。台積公司係首家提供 7 奈米製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司，同時亦領先業界導入極紫外光 (EUV) 微影技術協助客戶產品大量進入市場。其企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 www.tsmc.com.tw 查詢。

關於格芯

格芯是全球領先的特殊工藝半導體代工廠，提供差異化、功能豐富的解決方案，賦能我們的客戶為高增長的市場領域開發創新產品。格芯擁有廣泛的工藝平臺及特性，並提供獨特的融合設計、開發和生產為一體的服務。格芯擁有遍佈美洲、亞洲和歐洲的規模生產足跡，以其靈活性與應變力滿足全球客戶的動態需求。格芯為阿布達比穆巴達拉投資公司 (Mubadala Investment Company) 所有。欲瞭解更多資訊，請訪問 <https://www.globalfoundries.com/cn>。

#

台積公司代理發言人：
孫又文
企業訊息處資深處長
Tel: 03-568-2085
Mobile: 0988-937-999
E-Mail: elizabeth_sun@tsmc.com

Laurie Kelly,
GLOBALFOUNDRIES
VP Global Communications
+1 (518) 265-4580
Laurie.Kelly@globalfoundries.com